

軟磁性モールド材料

押出成形用 EMCコンパウンド



概要

押出成形用EMCコンパウンドは、ソフトフェライト粉末や軟磁性メタル粉末をPVCやSEBS樹脂に混合させた軟磁性モールド材料で、優れた磁気特性と押出成形性を両立しています。ケーブル被覆層にお使いいただくことで、インピーダンス付与によるノイズ抑制効果が得られます。

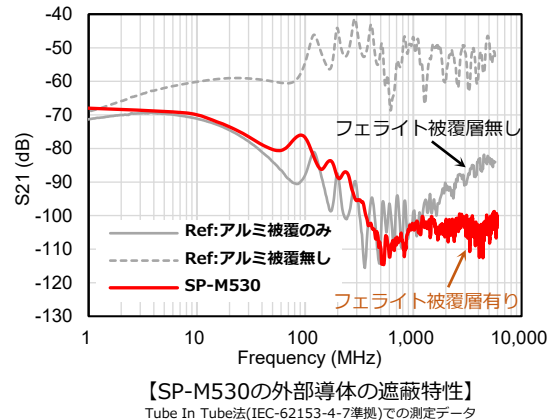
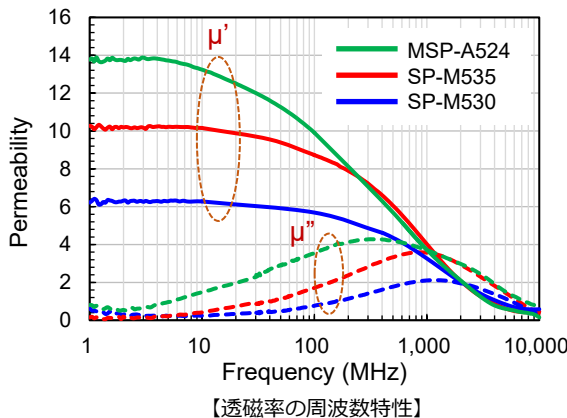
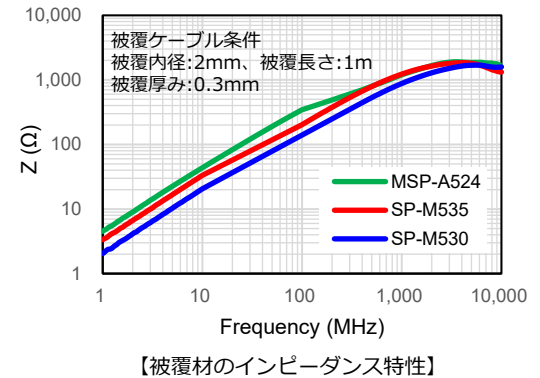
特徴

- 1** マイクロ波帯域で高いインピーダンス特性
シース構造により、広帯域で高いノイズ抑制効果が得られます。
- 2** 優れた押出成形性
樹脂複合化に適した特性を有する磁性粉末を使用しており、成形性に優れています。

製品情報

【代表製品の特性】

| 品名 | SP-M530 | SP-M535 | MSP-A524 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 材質 | Mn-Znフェライト /PVC | Mn-Znフェライト /PVC | Fe-Si-Al/PVC |
| 成形密度 (g/cm ³) | 3.0 | 3.5 | 2.4 |
| 流動性MFR (g/10min) [190℃/10kgf] | 20以上(参考値) | 20以上(参考値) | - |
| μ' at 10MHz | 6 | 10 | 13 |
| μ'' at 10MHz | 0.2 | 0.4 | 2 |
| μ' at 100MHz | 6 | 9 | 10 |
| μ'' at 100MHz | 1 | 2 | 4 |
| μ' at 400MHz | 5 | 6 | 5 |
| μ'' at 400MHz | 2 | 3 | 4 |



用途

- ノイズ抑制機能を付与したケーブル被覆材
- ノイズ抑制シート

